



# 平成24年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成23年7月29日

上場取引所 東

上場会社名 株式会社 リョーサン  
コード番号 8140 URL <http://www.ryosan.co.jp>

代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 三松 直人

問合せ先責任者 (役職名) 専務取締役経本部長 (氏名) 関 晴光

TEL 03-3862-2591

四半期報告書提出予定日 平成23年8月12日

配当支払開始予定日 —

四半期決算補足説明資料作成の有無 : 無

四半期決算説明会開催の有無 : 無

(百万円未満切捨て)

## 1. 平成24年3月期第1四半期の連結業績(平成23年4月1日～平成23年6月30日)

### (1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
24年3月期第1四半期	48,306	△4.5	540	△65.9	852	△55.1	535	△57.7
23年3月期第1四半期	50,580	31.8	1,584	373.0	1,901	270.0	1,264	538.7

(注) 包括利益 24年3月期第1四半期 125百万円 (△76.3%) 23年3月期第1四半期 529百万円 (—%)

	1株当たり四半期純利益	潜在株式調整後1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
24年3月期第1四半期	15.54	—
23年3月期第1四半期	36.70	—

### (2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
24年3月期第1四半期	157,237	116,520	74.0	3,377.59
23年3月期	163,479	117,780	72.0	3,413.87

(参考) 自己資本 24年3月期第1四半期 116,409百万円 23年3月期 117,660百万円

## 2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
23年3月期	—	40.00	—	40.00	80.00
24年3月期	—	—	—	—	—
24年3月期(予想)	—	20.00	—	40.00	60.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

## 3. 平成24年3月期の連結業績予想(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

(%表示は、通期は対前期、第2四半期(累計)は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
第2四半期(累計)	105,000	△1.4	1,100	△69.2	1,500	△62.2	800	△68.5	23.21
通期	230,000	6.4	3,500	△42.4	4,200	△39.0	2,500	△39.5	72.54

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

#### 4. その他

- (1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無  
新規 一社 (社名) 、 除外 一社 (社名)
- (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 有
- (3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
  - ② ①以外の会計方針の変更 : 無
  - ③ 会計上の見積りの変更 : 無
  - ④ 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数(普通株式)

① 期末発行済株式数(自己株式を含む)	24年3月期1Q	34,500,000 株	23年3月期	34,500,000 株
② 期末自己株式数	24年3月期1Q	34,752 株	23年3月期	34,704 株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	24年3月期1Q	34,465,253 株	23年3月期1Q	34,465,971 株

#### ※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビューの手続きの対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。

#### ※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半期決算短信(添付資料)3ページ「(3)連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 連結経営成績に関する定性的情報	2
(2) 連結財政状態に関する定性的情報	3
(3) 連結業績予想に関する定性的情報	3
2. サマリー情報（その他）に関する事項	4
(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動	4
(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用	4
(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示	4
3. 四半期連結財務諸表	5
(1) 四半期連結貸借対照表	5
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	
四半期連結損益計算書	
第1四半期連結累計期間	7
四半期連結包括利益計算書	
第1四半期連結累計期間	8
(3) 継続企業の前提に関する注記	9
(4) セグメント情報	9
(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記	10
4. 補足情報	11
(1) 所在地別セグメント情報	11
(2) 海外売上高	11

## 1. 当四半期決算に関する定性的情報

### (1) 連結経営成績に関する定性的情報

#### ①全体の概況

当第1四半期(平成23年4～6月)の世界経済は、3月に発生した東日本大震災の影響によって各国の生産活動に一時的な停滞が見られたものの、中国を始めとする新興国の順調な経済成長に牽引され、全般的に緩やかな回復基調を維持いたしました。また、我々が従事しておりますエレクトロニクス業界は、新興国における市場拡大に加え、スマートフォンやタブレットPC等の新しい商品群の急拡大やFA市場も堅調に推移したことから、成長が持続いたしました。

このような情勢下で、当社グループは売上高の拡大を果たすため、「急成長する新興国(中国・インド)への取り組み」「グローバル化する日系顧客への対応」「成長分野(カーエレクトロニクス・社会インフラ等)の開拓」を強力に推進すると共に、「収益体質の改善」にも取り組んでまいりました。

しかしながら、当第1四半期の業績は、東日本大震災の影響に加え、パソコン用DRAMやゲーム機用機構部品等の売上が減少したことから、売上高は483億6百万円(前年同期比4.5%減)、営業利益5億40百万円(前年同期比65.9%減)、経常利益8億52百万円(前年同期比55.1%減)、四半期純利益5億35百万円(前年同期比57.7%減)と減収減益の結果となりました。

#### ②セグメントの業績概況

##### イ. 半導体事業

当社グループでは、メモリ、システムLSI、個別半導体の販売並びにシステムLSIの開発を行っております。当第1四半期連結会計期間は、パソコン用DRAMや薄型テレビ用システムLSI等の売上が減少し、売上高は290億81百万円(前年同期比2.2%減)、営業利益は4億53百万円(前年同期比63.8%減)となりました。

##### ロ. 電子部品事業

当社グループでは、表示デバイス、電源、機構部品を販売しております。当第1四半期連結会計期間は、ゲーム機用機構部品等の売上が減少し、売上高は129億71百万円(前年同期比10.0%減)、営業利益は4億53百万円(前年同期比26.4%減)となりました。

##### ハ. 電子機器事業

当社グループでは、システム機器、設備機器を販売しております。当第1四半期連結会計期間は、車載電装用システム機器等の売上が減少し、売上高は47億30百万円(前年同期比2.6%減)、営業利益は91百万円(前年同期比24.8%減)となりました。

## ニ. 生産事業

当社グループでは、ヒートシンク（半導体素子用放熱器）を生産し、販売しております。当第1四半期連結会計期間は、薄型テレビ用ヒートシンク等の売上が減少し、売上高は15億22百万円（前年同期比3.7%減）、営業利益は1億31百万円（前年同期比27.0%減）となりました。

### (2) 連結財政状態に関する定性的情報

当第1四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べて62億41百万円減少し、1,572億37百万円となりました。

また、純資産は、前連結会計年度末に比べ12億59百万円減少して1,165億20万円となり、自己資本比率は74.0%となりました。

### (3) 連結業績予想に関する定性的情報

#### ①全体の業績見通し

今後を展望いたしますと、世界経済は新興国の内需拡大に支えられ、引き続き緩やかな回復基調が想定されております。また、東日本大震災によって大打撃を受けた日本経済におきましても、年後半から回復してくることが見込まれております。

このような状況の中で、当社グループは、「グローバル時代を勝ち抜く強靱な経営体質の構築」と「次期成長を支える新興国市場の開拓」に取り組んでいく考えであります。

なお、業績につきましては、「東日本大震災による一時的な生産活動停滞の影響」があるものの、「ルネサスエレクトロニクス事業の商権移管」等によって売上高の増加が見込まれます。しかしながら、利益面では「移管事業の円滑な立ち上げのための営業強化」等によって事業コストが増加することから、増収減益になる見通しであります。

なお、通期の業績見通しは次の通りです。

売上高	2,300億円	(前期比 6.4%増)
営業利益	35億円	(前期比 42.4%減)
経常利益	42億円	(前期比 39.0%減)
当期純利益	25億円	(前期比 39.5%減)

②事業の種類別セグメントの業績見通し

イ. 半導体事業

半導体事業では、車載電装用システムLSIや液晶ディスプレイ用ドライバIC等の売上増加が見込まれ、売上高は1,420億円（前期比14.7%増）となるものの、販売管理費の増加等により営業利益は28億円（前期比39.0%減）を予想しております。

ロ. 電子部品事業

電子部品事業では、車載電装用及び携帯電話用機構部品等の売上減少が見込まれ、売上高は580億円（前期比3.4%減）、営業利益は18億円（前期比19.9%減）を予想しております。

ハ. 電子機器事業

電子機器事業では、車載電装用システム機器等の売上減少が見込まれ、売上高は240億円（前期比7.2%減）、営業利益は5億円（前期比44.9%減）を予想しております。

ニ. 生産事業

生産事業では、薄型テレビ用ヒートシンク等の売上減少が見込まれ、売上高は60億円（前期比7.3%減）、営業利益は4億円（前期比17.8%減）を予想しております。

2. サマリー情報（その他）に関する事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

該当事項はありません。

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

影響額が僅少なものにつき、一部簡便的な手続きを採用しております。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

該当事項はありません。

4. 四半期連結財務諸表  
 (1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成23年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成23年6月30日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	43,240	28,377
受取手形及び売掛金	68,709	65,062
有価証券	—	9,999
たな卸資産	22,963	26,666
未収入金	4,472	3,223
未収還付法人税等	10	—
繰延税金資産	400	231
その他	288	457
貸倒引当金	△63	△111
流動資産合計	140,021	133,907
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	4,645	4,592
土地	8,126	8,125
リース資産(純額)	255	229
その他(純額)	654	602
有形固定資産合計	13,682	13,549
無形固定資産	701	758
投資その他の資産		
投資有価証券	3,156	3,078
長期預金	3,000	3,000
繰延税金資産	1,571	1,600
その他	2,447	2,420
貸倒引当金	△975	△949
投資損失引当金	△127	△127
投資その他の資産合計	9,072	9,022
固定資産合計	23,457	23,330
資産合計	163,479	157,237

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成23年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成23年6月30日)
<b>負債の部</b>		
流動負債		
支払手形及び買掛金	31,219	26,474
短期借入金	7,621	8,902
リース債務	116	110
未払費用	995	459
賞与引当金	—	338
未払法人税等	1,402	129
その他	1,745	1,715
流動負債合計	43,100	38,130
固定負債		
リース債務	194	169
退職給付引当金	2,327	2,357
その他	76	59
固定負債合計	2,597	2,585
負債合計	45,698	40,716
<b>純資産の部</b>		
株主資本		
資本金	17,690	17,690
資本剰余金	19,114	19,114
利益剰余金	83,606	82,763
自己株式	△85	△85
株主資本合計	120,325	119,482
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	295	249
繰延ヘッジ損益	△6	3
為替換算調整勘定	△2,954	△3,326
その他の包括利益累計額合計	△2,665	△3,073
少数株主持分	120	111
純資産合計	117,780	116,520
負債純資産合計	163,479	157,237

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書  
 (四半期連結損益計算書)  
 (第1四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 平成22年4月1日 至 平成22年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 平成23年4月1日 至 平成23年6月30日)
売上高	50,580	48,306
売上原価	45,917	44,378
売上総利益	4,663	3,927
販売費及び一般管理費	3,079	3,387
営業利益	1,584	540
営業外収益		
受取利息	26	22
受取配当金	125	133
為替差益	78	91
経営指導料	13	—
雑収入	89	105
営業外収益合計	333	352
営業外費用		
支払利息	11	38
雑損失	4	1
営業外費用合計	16	39
経常利益	1,901	852
特別利益		
貸倒引当金戻入額	79	—
特別利益合計	79	—
特別損失		
固定資産除売却損	1	1
特別損失合計	1	1
税金等調整前四半期純利益	1,979	851
法人税等	713	315
少数株主損益調整前四半期純利益	1,265	536
少数株主利益	0	1
四半期純利益	1,264	535

(四半期連結包括利益計算書)  
(第1四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 平成22年4月1日 至 平成22年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 平成23年4月1日 至 平成23年6月30日)
少数株主損益調整前四半期純利益	1,265	536
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△211	△46
繰延ヘッジ損益	△21	10
為替換算調整勘定	△503	△375
その他の包括利益合計	△735	△411
四半期包括利益	529	125
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	534	127
少数株主に係る四半期包括利益	△5	△2

(3) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(4) セグメント情報

I 前第1四半期連結累計期間 (自 平成22年4月1日 至 平成22年6月30日)

1. 報告セグメントの概要

当社グループの報告セグメントは、事業セグメント別の財務情報により作成し、最高経営責任者が定期的に業績を評価する対象となっているものであります。

当社グループは、本社に商品・製品別の事業本部を置き、各事業本部は取り扱う商品・製品について国内及び海外の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。

従って当社グループは事業本部を基礎として、「半導体事業」「電子部品事業」「電子機器事業」及び「生産事業」の4つを報告セグメントとしております。

各事業区分の主要な商品・製品の名称は下記の通りであります。

半導体事業……メモリ・システムLSI・個別半導体

電子部品事業……表示デバイス・電源・機構部品

電子機器事業……システム機器・設備機器

生産事業……ヒートシンク(半導体素子用放熱器)

2. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円)

	報 告 セ グ メ ン ト					調整額 (注)	四半期連 結損益計 算書計上 額
	半導体 事業	電子部品 事業	電子機器 事業	生産事業	計		
売 上 高							
外部顧客に対する売上高	29,723	14,417	4,859	1,580	50,580	—	50,580
セグメント間の内部売上高 又は振替高	—	—	—	—	—	—	—
計	29,723	14,417	4,859	1,580	50,580	—	50,580
セグメント利益	1,251	615	121	179	2,168	△584	1,584

- (注) 1. セグメント利益の調整額△584百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
2. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

Ⅱ 当第1四半期連結累計期間（自 平成23年4月1日 至 平成23年6月30日）

1. 報告セグメントの概要

当社グループの報告セグメントは、事業セグメント別の財務情報により作成し、最高経営責任者が定期的に業績を評価する対象となっているものであります。

当社グループは、本社に商品・製品別の事業本部を置き、各事業本部は取り扱う商品・製品について国内及び海外の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。

従って当社グループは事業本部を基礎として、「半導体事業」「電子部品事業」「電子機器事業」及び「生産事業」の4つを報告セグメントとしております。

各事業区分の主要な商品・製品の名称は下記の通りであります。

半導体事業……メモリ・システムLSI・個別半導体

電子部品事業……表示デバイス・電源・機構部品

電子機器事業……システム機器・設備機器

生産事業………ヒートシンク(半導体素子用放熱器)

2. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円)

	報 告 セ グ メ ン ト					調整額 (注)	四半期連 結損益計 算書計上 額
	半導体 事業	電子部品 事業	電子機器 事業	生産事業	計		
売 上 高							
外部顧客に対する売上高	29,081	12,971	4,730	1,522	48,306	—	48,306
セグメント間の内部売上高 又は振替高	—	—	—	—	—	—	—
計	29,081	12,971	4,730	1,522	48,306	—	48,306
セグメント利益	453	453	91	131	1,128	△588	540

(注) 1. セグメント利益の調整額△588百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

2. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記  
該当事項はありません。

4. 補足情報

(1) 所在地別セグメント情報

当第1四半期連結累計期間（自 平成23年4月1日 至 平成23年6月30日）

(単位：百万円)

	日 本	ア ジ ア	計	消去又 は全社	連 結
売上高及び営業損益					
売 上 高					
(1) 外部顧客に対する売上高	32,522	15,783	48,306	—	48,306
(2) セグメント間の内部売上高 又は振替高	2,239	152	2,392	(2,392)	—
計	34,762	15,935	50,698	(2,392)	48,306
営 業 利 益	326	162	488	52	540

- (注) 1. 国又は地域の区分は、地理的接近度によっております。  
 2. 各区分に属する主な国又は地域  
 アジア …… 香港・中国・台湾・タイ・シンガポール等

(2) 海外売上高

当第1四半期連結累計期間（自 平成23年4月1日 至 平成23年6月30日）

(単位：百万円)

	ア ジ ア	計
海外売上高	16,691	16,691
連結売上高	—	48,306
連結売上高に占める海外売上高の割合 (%)	34.6	34.6

- (注) 1. 国又は地域の区分は、地理的接近度によっております。  
 2. 各区分に属する主な国又は地域  
 アジア …… 中国・香港・韓国・タイ等  
 3. 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高（ただし、連結会社間の内部売上高を除く）であります。